

露笑科技股份有限公司

关于与合肥市长丰县签署建设第三代功率半导体 (碳化硅) 产业园战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本战略合作协议仅为合作各方的初步意向，具体合作事项需协议双方根据实际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 8 日与合肥市长丰县人民政府在合肥市政府签署《合肥市长丰县与露笑科技股份有限公司共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园的战略合作框架协议》。

公司将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目（以下简称“项目”或“本项目”），包括碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产，项目投资总规模预计 100 亿元。

合肥市长丰县人民政府为本项目提供优惠政策、资金（包括但不限于股权、债权投资）支持；为本项目提供土地、基础设施配备、用工等保障，对本项目的投资建设及运营提供必要的支持与协助；依法保障公司的合法权益，为项目投资提供便利条件。

本协议确定的内容是阐述双方战略合作意向、目标和条件的框架性文件。双方将在本协议基础之上，根据具体项目情况，由各相关方（包括但不限于与本协议内容相关的合肥市长丰县人民政府及其指定部门、合肥市长丰县人民政府所属国有公司或国有控股公司及其关联企业、合作伙伴等）签订具体合作协议，双方的权利义务以具体合作协议为准。

本框架协议书仅为意向性协议，在公司签署正式协议前，尚不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响。正式投资协议尚需另行签署并按《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规则履行相应审批程序及披露义务。

公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月九日